

# 國立高雄科技大學

## 「半導體封裝測試產業學分學程」規劃書

### 一、學分學程中文名稱

半導體封裝測試產業學分學程

### 二、學分學程英文名稱

Semiconductor Packaging and Testing Industry Credit Program

### 三、規劃設置單位

電機與資訊學院

### 四、參與學術單位

電子工程系(建工校區)、半導體工程系、電子工程系(第一校區)、電機工程系、電腦與通訊工程系、資訊工程系。

### 五、設置宗旨

台灣 IC 封裝與測試產業，穩坐全球之冠，隨著 IoT 應用、5G 通訊技術興起，台灣 IC 封裝與測試業者持續布局高階封裝與異質整合技術，以拉大與競爭業者之差距，所以必須持續培育優質的 IC 封裝與測試人才。因此，本校電機與資訊學院規劃半導體封裝測試技術能力培養課程，以提升本院電子、電機、資工、微電子、電通、電訊系之實務技術能力，為台灣產業厚植半導體封裝測試相關技術人才。

### 六、實施學制

日間部大學部

### 七、課程規劃及修讀相關規定

- (一) 凡國立高雄科技大學(以下簡稱本校)大學部學生，皆可修讀半導體封裝測試產業學分學程，所開設之課程，且應於每學期加退選期間內辦理之。
- (二) 招收名額以本校選課須知所規定之選修人數為限制。
- (三) 跨領域學程最低修習學分總數至少 20 學分，各學程選修科目如下表所列。
- (四) 學生修習本學程之學分依各系規定併入畢業最低總學分數內，且受每學期修習學分上限之規定。
- (五) 學生修畢滿足本學程學分規定之課程且成績及格者，得向綜合業務處申請本產業學分學程證書。
- (六) 本辦法未規定之事宜，悉依本校學則及相關法令之規定辦理。
- (七) 本辦法經電機與資訊學院課程委員會會議通過後，提送校課程委員會審核通過後實施，修正時亦同。

課程類別	課程名稱
基礎課程 (任選 6 學分以上)	半導體封裝跨領域學程基礎課程 半導體測試跨領域學程基礎課程
進階課程 (任選 6 學分以上)	半導體封裝跨領域學程進階課程 半導體測試跨領域學程進階課程
專業課程 (任選 6 學分以上)	半導體封裝跨領域學程專業課程 半導體測試跨領域學程專業課程
實習學分 (任選 2 學分以上)	<p>暑期實習 (2 學分) 學期實習(一) (10 學分) 學期實習(二) (10 學分)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 必須完成校外相關職場實習至少 320 小時(2 個月)。</li> <li>2. 選讀學期實習(一)或(二)者，經電機與資訊學院與實習輔導老師確認實習工作符合半導體封裝測試領域，無須修畢專業課程 6 學分。</li> </ol>

※此學程選讀可不用跨系選修。

學程審查	規劃設置單位核章
<p>113 年 04 月 09 日 院級課程會議通過 113 年 05 月 08 日 校課程會議通過 113 年 06 月 05 日 教務會議通過</p>	